

2020-2026年中国晶圆市场 分析与前景趋势报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2020-2026年中国晶圆市场分析与前景趋势报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/huagong/114382VC1M.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

根据调查数据显示，2017年有809亿美元资本其中228亿美元用于投资晶圆厂，为占比最多的去向，比去年增加4%。中国大规模兴建晶圆厂，将引发硅片需求走高。预计于2017~2020年间投产的前端半导体晶圆厂将达到62座，其中26座设于大陆，占全球总数42%。中国晶圆厂建设支出2017年达到60亿美元，2018年将达到66亿美元，规模空前，打破了没有单一国家/地区一年内在晶圆厂建设上花费超过60亿美元记录。

硅片在晶圆厂所有制造材料中占比为30%-35%，是晶圆厂最重要的原料，晶圆厂的兴建必然引发对硅片的进一步需求。因此本轮硅片供不应求的状况可能将在未来两年持续，且中国晶圆厂可能将是硅片需求增长的重要动力。晶圆制造设备在设备销售额占比基本保持80%左右。

8寸及以下硅片主要应用于：汽车，工业电子，物联网、传感器等。12寸硅片主要应用于：手机、NAND、DRAM、CPU、SoC等。由于平均售价的大幅增长，DRAM和NAND闪存市场在2018年的增长率分别达到37%和17%，均远超前预期，同时，DRAM的市场规模将达到996亿美元，成为IC行业最大的单一产品类别。8寸和12寸硅片制造芯片个数对比图

智研数据研究中心发布的《2020-2026年中国晶圆市场分析与前景趋势报告》共九章。首先介绍了晶圆相关概念及发展环境，接着分析了中国晶圆规模及消费需求，然后对中国晶圆市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国晶圆面临的机遇及发展前景。您若想对中国晶圆有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 2018年国内外晶圆行业整体运行态势分析

第一节 2018年世界晶圆行业运行总况

一、全世界晶圆的产能

二、硅片市场的国际化和生产垄断化已经形成

三、硅片制造技术进一步升级

第二节 2018年中国晶圆行业的发展形势综述

一、中国晶圆稳步发展

二、中国晶圆产销回顾

第三节 2018年中国晶圆生产主要地区项目建设动态分析

一、涿鹿打造国内最大晶圆生产研发基地

二、青海晶圆产业化项目技术取得突破

三、亿元晶圆项目入驻杞县

四、青海聚阳能硅业年产3500吨晶圆项目开建

第四节 2018年中国硅单晶技术取得的重要进展

一、12英寸硅单晶生长技术已经成熟

二、有效控制原生颗粒缺陷形成

三、12英寸硅单晶抛光片加工技术成熟

四、外延优化衬底技术获得发展

第五节 2018年中国晶圆技术及生产设备分析

一、中国硅单晶生产设备发展现状

二、中国硅单晶生产设备技术取得重大突破

三、中国太阳能硅单晶生产设备发展分析

1、太阳能硅单晶生产设备销量直线上升

2、太阳能硅单晶生产设备发展水平亟待实质性提高

第二章 2018年中国晶圆行业市场发展环解析

第一节 国内宏观经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、2018年中国宏观经济发展预测分析

第二节 2018年中国晶圆市场政策环境分析

一、晶圆、晶圆片加工贸易单耗标准

二、相关行业政策

三、法律法规

第三节 2018年中国晶圆市场社会环境分析

第三章 2018年中国晶圆行业市场运行态势剖析

第一节 2018年中国晶圆产业技术研究新进展

一、晶圆技术指标分析

二、晶圆加工成晶圆抛光硅片工艺流程

三、晶圆产业化节能技术取得科技突破

第二节 2018年中国晶圆重点区域市场动态分析

一、宜昌南玻成功拉制出直径8英寸晶圆

二、肥东获晶圆技术新成果

三、榆林光伏产业第一根太阳能级晶圆下线

第三节 2018年中国晶圆产业项目研究

一、晶圆、单晶切片生产项目

二、晶圆中外合资项目

三、晶圆产业招投标分析

第四节 2018年中国晶圆产业热点问题探讨

第四章 2015-2018年中国晶圆制造所属行业数据监测分析

第一节 2015-2018年中国晶圆制造所属行业总体数据分析

一、2016年中国晶圆制造所属行业企业数据分析

二、2017年中国晶圆制造所属行业企业数据分析

三、2018年中国晶圆制造所属行业企业数据分析

第二节 2015-2018年中国晶圆制造所属行业不同规模企业数据分析

一、2016年中国晶圆制造所属行业不同规模企业数据分析

二、2017年中国晶圆制造所属行业不同规模企业数据分析

三、2018年中国晶圆制造所属行业不同规模企业数据分析

第三节 2015-2018年中国晶圆制造所属行业不同所有制企业数据分析

一、2016年中国晶圆制造所属行业不同所有制企业数据分析

二、2017年中国晶圆制造所属行业不同所有制企业数据分析

三、2018年中国晶圆制造所属行业不同所有制企业数据分析

第五章 2018年中国晶圆市场深度剖析

第一节 2018年中国晶圆市场总况

一、晶圆加工企业规模及产能分析

2017年全球硅晶圆（含磊晶硅晶圆）出货面积连续四年打破历史纪录，连续5年维持增长，达到118.10亿平方英寸，较2016年增长9.98%。此外，由于下游需求旺盛，厂家持续扩大产能，2018年前3季度全球硅晶圆出货面积达到95.03亿平方英寸，再创历史新高。根据SEMI在2018

年10月16日对2018-2021年全球硅晶圆片出货量的预测，2018年硅晶圆片出货量将达到124.45亿平方英寸；同时，增长势头将延续到2021年，即未来几年全球硅晶圆市况将持续强劲

。2011-2018年全球硅晶圆出货量及增速

二、晶圆的市场需求及增长情况

三、晶圆市场供需形势

四、信息家电和通信产品需求旺盛对晶圆市场的推动

第二节 2018年中国晶圆市场价格分析

一、中国晶圆重点区域市场价格走势

二、影响价格因素分析

第六章 2018年中国晶圆市场竞争格局透析

第一节 2018年中国晶圆行业竞争现状

一、品牌竞争分析

二、价格竞争分析

三、营销方式竞争分析

第二节 2018年中国晶圆行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、生产企业的集中分布

第三节 2018年中国晶圆行业竞争中存的问题

第四节 2020-2026年中国晶圆行业竞争趋势分析

第七章 2018年中国晶圆优势生产企业竞争力分析

第一节 浙江金瑞泓

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第二节 昆山中辰

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第三节 北京有研总院

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第四节 中国电科46所

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第五节 淮安德科玛

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第六节 华力微电子

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第七节 北方华创

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第八节 中微半导体

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第九节 晶盛机电

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第十节 盛美半导体

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

第八章 2020-2026年中国晶圆行业发展趋势与前景展望分析

第一节 2020-2026年中国晶圆行业发展前景分析

第二节 2020-2026年中国晶圆行业发展趋势分析

一、晶圆技术发展方向分析

二、晶圆技术与节能趋势

第三节 2020-2026年中国晶圆行业市场预测分析

一、晶圆行业市场产量预测分析

二、晶圆行业市场销量预测分析

第四节 2020-2026年中国晶圆市场盈利预测分析

第九章 2020-2026年中国晶圆行业投资战略研究（）

第一节 2018年中国晶圆投资概况

一、中国晶圆产业投资准入情况

二、国家扶持项目晶圆控制项目

第二节 2020-2026年中国晶圆行业投资机会分析

一、晶圆重点区域投资潜力分析

二、与产业政策调整相关的投资机会分析

第三节 2020-2026年中国晶圆行业投资风险分析

一、宏观调控政策风险

二、市场竞争风险

三、技术风险

四、金融风险

第四节 投资建议（）

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/huagong/114382VC1M.html>